

郑州回收集成电路精准报价 收购郑州集成电路IC库存

产品名称	郑州回收集成电路精准报价 收购郑州集成电路IC库存
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

郑州回收集成电路精准报价 收购郑州集成电路IC库存

M25P16-VMN6P 1429-24/19-54 MCR10EZHF1004 APHHS1005CGCK C5750X7T2E225M250KE
UL3302HF-30(STR) 1/0.10 P150 PS2801-1-F4-A BAV99LT1G MCR50JZHFLR250
CRCW12102K00FKEA RC0201FR-0739RL? PE9945DV-312.50M ?5SGXEA3H3F35C3N

1990年日本IBM公司公布了用感光树脂作绝缘层的积层法多层板新技术，1997年，包括积层多层板在内的高密度互连的多层板技术走向发展成熟期。与此同时，以BGA、CSP为典型代表的塑料封装基板有了迅猛的发展。20世纪90年代后期，一些不含溴、锑的绿色阻燃等新型基板迅速兴起，走向市场。

我国基板材料业经40多年的发展，目前已形成年产值约90亿元的生产规模。2000年，我国大陆覆铜板总产量已达到6400万平方米，创产值55亿元。其中纸基覆铜板的产量已跻身世界第三位。但是在技术水平、产品品种、特别是新型基板的发展上，与国外先进国家还存在相当大的差距。